



⇨ BUILDING THE FUTURE THROUGH CUTTING-EDGE PRECISION PROCESSING TECHNOLOGIES

●
第65期事業報告書

平成15年4月1日 ⇨ 平成16年3月31日

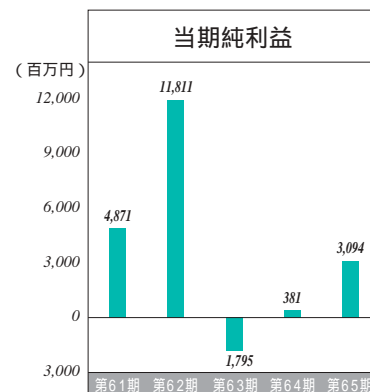
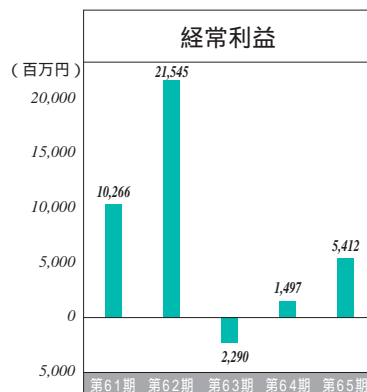
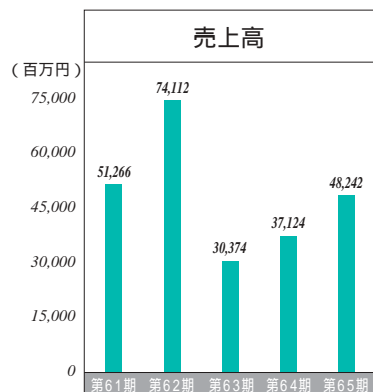
DISCO CORPORATION



主要財務数値(連結)

(単位：百万円)

	平成12年3月期 (第61期)	平成13年3月期 (第62期)	平成14年3月期 (第63期)	平成15年3月期 (第64期)	平成16年3月期 (第65期)
売上高	51,266	74,112	30,374	37,124	48,242
経常利益	10,266	21,545	2,290	1,497	5,412
当期純利益	4,871	11,811	1,795	381	3,094
1株当たり当期純利益(円)	230.41	367.76	55.91	11.80	94.72
株主資本	40,845	51,601	49,203	48,746	51,002
総資産	67,054	86,435	63,720	61,908	80,353
株主資本当期純利益率(ROE、%)	14.3	25.6	3.6	0.8	6.2



目次

主要財務数値(連結)	1
株主の皆さまへ	2
Q&A	4
DISCO TODAY	5
部門別営業概況	7
業績のポイント(連結)	9
財務諸表(連結)	11
財務諸表(単独)	12
会社概要/役員	13
株式概要	14

株主の皆さまへ

半導体業界の設備投資本格化により大幅な増益を実現

半導体業界、電子部品業界におきましては、当期は、カラー液晶搭載携帯電話、カメラ付き携帯電話の急速な普及やPCの買い替え需要の顕在化に加え、デジタルスチールカメラ、DVDレコーダ、その他デジタル家電向けなどさまざまな最終アプリケーションで需要が拡大しました。地域別にみると、日本およびアジア地域が前期に引き続き好調に推移し、米国も堅調な伸展をみせるとともに欧州地域も力強さを回復しました。これを受け、当社の属する半導体製造装置市場におきましても、半導体メーカーの収益改善とともに、半導体生産や設備投資の回復が鮮明なものとなり、製造装置に対する需要が本格的に回復いたしました。

このような市場環境の中、当社は、前期と同様にCS向上への取り組みや新製品・新機種の販売強化を図り、積極的な営業活動を展開することで、さらなる売上増加を目指しました。また、製造要員（アウトソース）の増加などにより能力増強を図り、急増する受注に対応してまいりました。当期は、世界の半導体生産個数が過去のピークを更新するなど、半導体メーカーの活発な生産状況を反映した形で、消耗品である精密ダイヤモンド砥石の受注が堅調に推移し、過去最高の売上高となりました。また、期の後半からは半導体メーカーの設備投資の本格回復から機械装置の引き合いが急激に増加しました。

以上の結果、当期の連結売上高は482億42百万円（前期比30.0%増）となりました。また、増収に加え、機械の中での新製品・新機種の売上構成比の増加などに伴い利益率が改善し、連結営業利益は56億25百万円（前期比246.0

%増）連結経常利益は54億12百万円（前期比261.4%増）、連結当期純利益は30億94百万円（前期比710.5%増）、1株当たり当期純利益は94.72円（前期比702.7%増）と、大幅な増益を達成することができました。配当につきましては、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的な配当に努めるとともに、業績に応じて弾力的な還元策を図るという方針に基づき、当期は普通配当を前期比10円増の1株当たり30円（うち期末は15円）とさせていただきます。

なお、前期に引き続き役員や従業員の業績向上努力とそれに対する成果配分を株主利益により密接に関連付けることにより、業績向上と株主重視の経営を一段と進める狙いから、当社および子会社の役員・従業員の一部にストックオプションを付与いたしました。

「DISCO VISION」の達成に向けて - 2010年に当社が目指す姿 -

当社は、2010年に「このような姿になりたい」という企業としての目標を「DISCO VISION」という形で示し、全社的に共有しております。その

中で、当社の成長を支える要素として「十分な経済的能力」を挙げていますが、これにつきましては、当社の置かれているマーケットの構造的要因であるシリコンサイクルを勘案する必要があります。変動の大きな単年度ごとの状況ではなく4年累計で経済的能力を測ることによって、企業実態のトレンドをとらえることが可能となるからです。そこで、「DISCO VISION」では、2010年までに「4年累計で、20%以上の売上高経常利益率を維持する態勢ができています」とことを中期目標としております。

これを実現させるためには、トップシェアを誇る超微細加



代表取締役社長兼COO 溝呂木 育

工分野において、当社独自の高度な「Kiru・Kezuru・Migaku（切る、削る、磨く）」技術を駆使し、お客様のニーズに対応した高付加価値のソリューションを提供し続けることを基本に、収益構造の改革や業務コストの低減など、総合的な施策が重要であると考えています。具体的には、収益構造面では、新たな用途開拓などによって消耗品ビジネスの売上を早期に現在の2倍の水準に高めるとともに、付加価値の高い機械装置の開発やモデルチェンジなどにより利益率の向上を目指します。また、コスト低減策としては、全社的なビジネスプロセス改革（BPR）に取り組み、各部門のマネージメントスキル改革により業務効率を徹底して改善してまいります。

持続的な成長の根幹を成す「DISCO VALUES」

当社では、多年にわたり「組織経営」、すなわち企業の質的側面の充実に取り組んできました。その根幹を成すのが「DISCO VALUES」です。これは、全社の価値観であるとともに意思決定基準であり、役員をはじめ全従業員の活動のあり方を示すものです。

近年、コーポレート・ガバナンスの重要性が唱えられていますが、当社においては、この「DISCO VALUES」を全従業員に浸透させ、価値観の共有化を図ることがコーポレート・ガバナンスの基本と考えています。そして、組織経営に関わるさまざまな問題については、1995年から外部の専門家を加え「企業文化の良質化」を目的とする全社的なプロジェクトを立ち上げ、経営陣が毎月1回定例会議を開催し、ディスコの企業としてのあり方や経営のあり方等の討議を重ねるなど、「経営の主要業務」として継続的に取り組んでおります。

当社が最終的に目指すものは、価値観の共有化の輪をさらに広げることで、ステークホルダーをはじめとする多くの「人」との間により良い価値交換を実現させ、そこから生まれる良質な企業文化のもとで企業価値の向上を図っていくこと

です。当社は、この「価値観の共有化」「企業文化の良質化」への継続的な取り組みが、ディスコに持続的な成長をもたらす最も確実な方法であると考えております。

市場の回復トレンドを着実に取り込み、さらなる成長軌道へ

世界経済をみますと、米国の景気拡大の持続、一大消費地としての中国の台頭、長らく低迷していた日本経済の回復など、引き続き良い方向に向かっていきます。半導体市場・半導体製造装置市場においても、企業のIT投資の回復、PC買い替え需要の持続、デジタル家電の普及、携帯電話の高品質化などにより、短期的な調整はあったとしても基本的には回復傾向がまだ続くものと考えています。その中で、当社との関係においては、ウェーハの300mm化の進展が引き続き見込まれるうえ、チップの薄型化やパッケージング技術の革新（CSP化の進展）ウェーハメーカーでのグラインダ導入などのプラス要因がさらに期待されます。

こうした中、当社は来期も引き続き、300mmウェーハ装置需要の着実な取り込み、ウェーハ極薄加工やパッケージングでのベストソリューションの提供に注力してまいります。また、一昨年発表し、既に販売実績のあるレーザーソーの市場への浸透に引き続き努めてまいります。さらに、有望市場である中国においては、販売体制を一層強化し当社の優位性を確保していきたいと考えております。

当社は今後も、市場ボリュームへの追従のみでなく、市場の質的・技術的ニーズにも対応した製品をタイムリーかつ的確に投入していくことにより、市場の成長をアウトパフォーマンスしていきたいと考えております。

株主の皆さまにおかれましては、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成16年6月

代表取締役社長兼COO

Q1 前期からの業績回復については、どのような見方をしていますか。
また、今般のシリコンサイクルの回復はいつまで続くと考えていますか。

前期からの業績回復は一時的なものではなく、トレンドの端緒であると認識しています。最終製品、部品の両方で需給環境に特段の不安感は見られず、マーケットの在庫にも余剰感はありません。したがって、現時点では、今般のシリコンサイクルの回復が下期に失速するとはみていません。

また、2000年の業績ピーク時と異なり、半導体メーカーの設備投資スタンスに過熱感がないのも今回の特徴といえます。

なお、半導体製造における後工程である当社にとっては、今後も半導体景気の良し悪しで左右される動きとは別に、300mm化、パッケージ向けなどの構造的な需要拡大が見込まれます。

Q2 価格引き下げ圧力の現状とコスト低減策については、どのように対応していますか。

価格の下落傾向は収まったものと認識しています。しかし、当社では現在、機械のモデルチェンジの時期にさしかかり、新旧モデルの販売が併存しているという問題があります。旧モデルについては、他社との競争のため価格面では対応せざるを得ない場合があり、粗利益率の回復が鈍くなっていますが、販売は来期中にはほぼ終了し、利益率が改善する見込みです。消耗品である精密ダイヤモンド砥石は、過去のピーク時並みのマージンを確保しています。

コスト低減策としては、ビジネスプロセス改革(BPR)を実施しています。2010年までに構造的に経費・原価を毎年5%ずつ圧縮し、売上高経常利益率を4年累計平均で安定的に20%確保できる態勢にするという目標に向け、固定費の圧縮と変動比率の低減に取り組んでいます。

Q3 顧客満足度向上のための取り組みには、どのようなものがありますか。

顧客満足度を高めるために何よりも重要なことは、お客様の加工ニーズにマッチした最適なソリューションを提供し、常にお客様が抱える問題に迅速に対応することです。超微細加工においては、単純に製品の性能だけではお客様が求める加工結果を実現することはできません。

当社は「装置」「砥石」の両方を1社で提供できる唯一のメーカーであり、その両方の製品を最適に組み合わせる「アプリケーション技術」の充実が可能となります。これらの2つの製品に「アプリケーション技術」も含めた3つの要素を、高度なレベルで融合させることで、お客様に常に最適なソリューションを提供する努力を続けています。さらに、そのソリューションをより迅速に提供するため、世界各地にアプリケーションラボを設け、お客様の要望に的確に対応できる体制を整えています。

そして、技術進展の著しいこの業界において、常に最適な加工結果を提供するためには従来の加工方法にこだわらない、新たな技術の開発も重要課題と認識しています。特に、近年さまざまなソリューションを生み出しているレーザーアプリケーションについては、専任の技術者を増強し、積極的に取り組んでいます。

当社は、グローバルなサービス展開で、引き続き高度な「Kiru・Kezuru・Migaku」についてのトータルソリューションの提供に注力し、お客様の期待に応えてまいります。



Corporate Social Responsibility

環境、健康、安全に先進的に取り組みます。

ディスコは企業の社会的責任という観点から、積極的にEHS (Environment, Health and Safety) を経営課題として取り上げ、「環境と健康、安全への配慮はすべての企業活動に共通する考えである」ことを全社員に徹底し、さまざまなEHS推進活動を展開しています。

事故ゼロから危険ゼロへ

広島事業所がOHSAS(オーサス)18001の認証を取得
EHS活動の一環として、2004年2月、広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)において、品質のISO 9001、環境のISO 14001に続き、労働安全衛生の国際規格であるOHSAS 18001の認証登録を受けました。

ディスコでは、従業員およびステークホルダーの安全と健康を確保する経営方針を掲げ、生産拠点である広島事業所での先行取得に続き、2005年度以降は、本社およびその他拠点においても取得し、社会にとって存在価値の高い企業を目指します。

OHSAS : 労働安全衛生アセスメントシリーズ
(Occupational Health and Safety Assessment Series)

Health and Safety



OHSAS(オーサス)18001認証
広島事業所では、すべての事業活動においてリスクアセスメントを行い、リスク低減に向けた改善を継続することにより、「事故ゼロ」からさらに進めて「危険ゼロ」の実現を目指しています。

環境への配慮

グリーンプロダクトガイドラインの概要

ディスコは資源循環型社会の一員として、ライフサイクルにおける環境負荷を低減した装置を提供するための設計ガイドライン「グリーンプロダクトガイドライン」を策定し実施しています。

ガイドラインの基本方針

1. エコ設計思想を取り入れる
2. 使用制限物質を明確化する

再生資源および再生部品の利用促進を図るうえで、適切な情報を関係先へ提供する。

使用材料を削減する。

環境影響化学物質の使用を極力避ける。

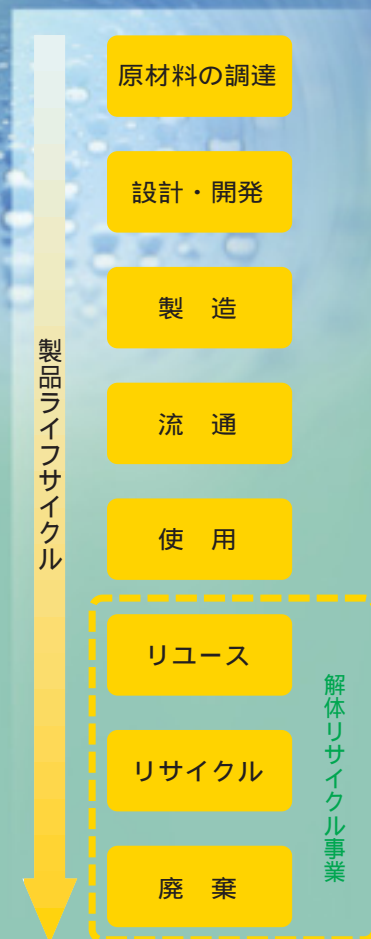
製品のライフサイクルにおける環境への影響を評価する。
エネルギー効率が良く、エネルギー消費量等の少ない製品を提供する。

回収した部品を、資源の有効利用と廃棄物の減量化に対応するため、可能な限り中古部品として流通させたり、補修用部品として再使用する。

廃棄物を削減する。

環境省より「広域再生利用指定産業廃棄物処理者」の認可を受け、自社製品の解体リサイクル事業を実施しています。(2003/10/1より)

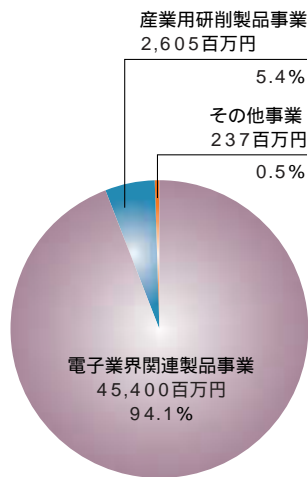
Environment



ディスコでは「社会環境報告書」を発行し、企業の社会的責任に関する活動の報告を行っています。同報告書は当社ホームページでご覧いただけます。(http://www.disco.co.jp/)

部門別営業概況

第65期 部門別売上構成



ダイシングソー

電子業界関連製品事業

電子業界関連製品事業におきましては、ダイシングソー、グラインダなどの機械装置や精密ダイヤモンド砥石などの消耗品、精密電子部品の製造・販売と、アフターサービスを行っています。販売先は半導体メーカーや電子部品メーカーなどが占めており、当社の連結売上高の94.1%を占める中核セグメントです。

当期は、カラー液晶やカメラ搭載携帯電話の急速な普及、PCの買い替え需要の顕在化に加え、デジタルスチールカメラ、DVDレコーダなどデジタル家電市場の本格的拡大など、半導体の最終アプリケーションに関して、需要の量的増加と質的多様化が同時進展しました。これを反映して、半導体製造装置市場も本格的な需要拡大局面に入ったことから、半導体メーカーの生産・収益の回復が顕著となり、能力増強のための設備投資も活発化しました。

当社の製品では、消耗品である精密ダイヤモンド砥石の受注が、2003年3月期において回復基調に入り、さらに当期は過去最高の売上を記録するなど、半導体メーカーの活発な生産状況を反映して引き続き好調に推移しました。一方、ダイシングソー、グラインダなどの機械装置については、受注高が前期の1.5倍以上にまで伸びました。これは、上期は携帯電話、デジタルカメラなどに搭載されるチップサイズパッケージ(CSP)やCCD(電荷結合素子)、CMOSセンサー、LEDなどの光半導体向けダイシングソー、ウェーハメーカー向けグラインダなどが牽引し、下期にはPC出荷台数の増加なども加わって半導体全体としての回復が鮮明となったことによるものです。特に、期の後半からは急速に機械装置の引き合いが活発化し、本格的なシリコンサイクルの回復局面に入りました。地域別では、半導体出荷の回復が著しい日本およびアジア(シンガポール、韓国、台湾)が大幅増収の牽引役となりました。



精密ダイヤモンド砥石



産業用ダイヤモンド砥石

この結果、当期の売上高は454億円（前期比32.1%増）となり、営業利益は87億82百万円（前期比103.1%増）となりました。

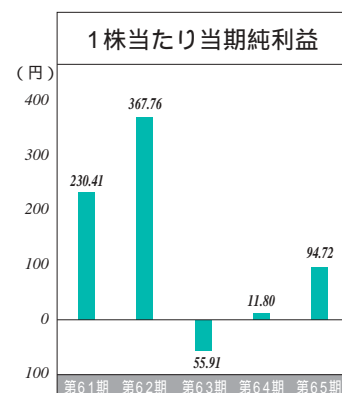
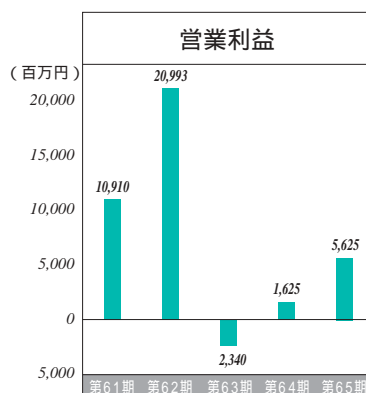
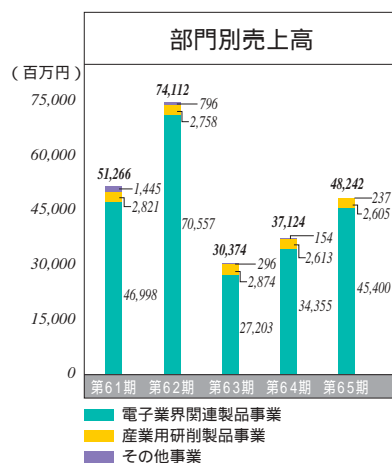
なお当期は、200mmウェーハ対応のフルオートマチックダイシングソーDFD6240、200/300mmウェーハ対応のフルオートマチックグラインダ/ポリッシャDGP8760、極薄ウェーハの研削・ストレスリリーフ工程から表面保護テープ剥離工程を確実に安全に一貫プロセスで行うDGP8760/DFM2700インラインシステムを開発し、2003年12月に開催されたセミコンジャパンで発表しました。このほか、ウェーハ極薄加工のためのドライポリッシャ、高速最先端デバイスに使用されるLow-k膜除去などのレーザーソーの市場への浸透に努めました。

産業用研削製品事業・その他事業

産業用研削製品事業におきましては、道路やアスファルトなどを研削する産業用ダイヤモンド工具を製造・販売しています。当期は、積極的な販売活動を展開しましたが、国や地方公共団体による公共事業抑制策などの影響を受け、売上高は26億5百万円（前期比0.3%減）となりました。一方で、コスト削減などの合理化に努めた結果、営業利益は1億87百万円（前期比45.5%増）となりました。今後も引き続き、海外に販路を開拓するとともに、海外製造比率を高めてコスト競争力を強めていく予定です。

その他事業は、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けにコンピュータソフトを開発するソフト開発会社が担っています。もともと、当社のダイシングソーに使用するソフトを開発するために設立した会社ですが、現在では半分以上が当社以外からの仕事となっています。当期の売上高は2億37百万円（前期比53.5%増）、営業利益は40百万円（前期比813.1%増）となりました。

業績のポイント(連結)



部門別売上高

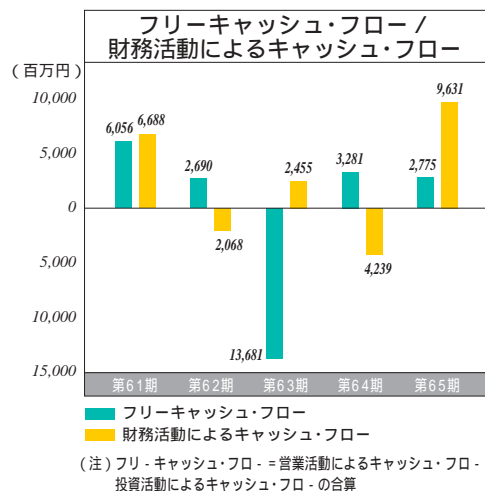
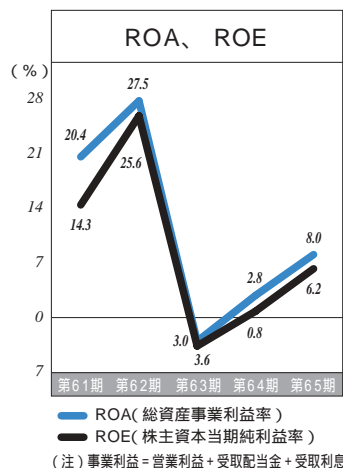
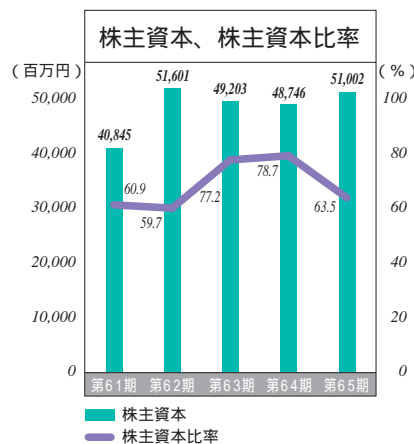
前期に引き続き半導体市場の回復基調が続いたことに伴い、機械を中心に受注が大幅に増加しました。また、精密ダイヤモンド砥石も前期比で高い伸びを示し、売上高は過去最高水準を記録しました。この結果、電子業界関連製品事業の売上高は454億円(前期比32.1%増)となり、全体の連結売上高は482億42百万円(前期比30.0%増)となりました。

営業利益

売上高の大幅増加と、機械のモデルチェンジ進展により採算の良好な新機種へのウェートが高まり粗利益率が改善されたこと等により、電子業界関連製品事業を中心として営業利益は大幅増益となりました。

1株当たり当期純利益

当社は第6-2期において、1:1.5の株式分割を実施しています。当期は業績の本格回復に伴う当期純利益の大幅増益(前期比710.5%増)により、1株当たり当期純利益が前期11.80円から当期94.72円へと大幅に増加しました。



株主資本、株主資本比率

株主資本は、当期純利益が30億94百万円となったことなどから22億56百万円増加しました。総資産に占める株主資本の比率(株主資本比率)は、平成15年6月に実施した新株予約権付社債90億円の発行や、売上高の拡大に伴う売上債権の増加などで分母である総資産が前期比184億44百万円増加したため、前期比15.2ポイント低下し、63.5%となりました。

ROA、ROE

総資産から得られる収益率であるROAは90億円の資金調達に伴う現預金の増加、売上高拡大に伴う売上債権の増加など、分母となる総資産が増加しましたが、利益面での改善がこれを上回り、前期比5.2ポイント向上し、8.0%となりました。株主資本から得られる収益率であるROEも、利益面での回復を主因として、5.4ポイント改善し、6.2%となりました。

キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローが63億60百万円と前期比23億42百万円増加しましたが、本年11月に竣工予定のR&Dセンター(仮称)の工事着手金支払いなどで投資活動によるキャッシュ・フローも35億85百万円と前期比28億48百万円増加し、フリーキャッシュ・フローは27億75百万円と前期比5億6百万円減少しました。また、R&Dセンター土地・建物の残額支払いに備え、新株予約権付社債90億円を発行したため、財務活動によるキャッシュ・フローは96億31百万円と前期比138億70百万円増加となりました。

財務諸表(連結)

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第64期 (平成15年3月31日現在)	第65期 (平成16年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	6,666	19,031
受取手形及び売掛金	11,310	16,903
棚卸資産	15,954	13,692
その他	1,976	1,971
流動資産合計	35,908	51,598
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,208	8,462
機械装置及び運搬具	2,942	3,641
土地	5,722	5,710
その他	2,734	3,975
有形固定資産合計	19,608	21,788
無形固定資産		
投資その他の資産	800	774
投資有価証券	1,459	2,001
その他	4,132	4,189
投資その他の資産合計	5,992	6,191
固定資産合計	26,000	28,754
資産合計	61,908	80,353
(負債の部)		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,787	5,652
短期借入金	1,634	1,479
未払法人税等	365	2,098
その他	3,538	5,784
流動負債合計	9,326	15,015
固定負債		
新株引受権付社債	312	—
新株予約権付社債	—	9,000
長期借入金	966	2,520
退職給付引当金	1,596	1,723
その他	882	913
固定負債合計	3,757	14,156
負債合計	13,084	29,171
(少数株主持分)		
少数株主持分	77	179
(資本の部)		
資本金	9,772	9,795
資本剰余金	10,638	10,664
利益剰余金	28,529	30,970
その他有価証券評価差額金	18	138
為替換算調整勘定	204	547
自己株式	9	18
資本合計	48,746	51,002
負債、少数株主持分及び資本合計	61,908	80,353

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	第65期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
売上高	37,124	48,242
売上原価	20,344	25,224
販売費及び一般管理費	15,153	17,392
営業利益	1,625	5,625
営業外収益	409	432
営業外費用	537	644
経常利益	1,497	5,412
特別利益	149	58
特別損失	153	184
税金等調整前当期純利益	1,493	5,286
法人税、住民税及び事業税	589	2,293
法人税等調整額	579	156
少数株主利益又は少数株主損失	56	54
当期純利益	381	3,094

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位：百万円)

科目	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	第65期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,018	6,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	737	3,585
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,239	9,631
現金及び現金同等物に係る換算差額	137	282
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	1,096	12,123
現金及び現金同等物の期首残高	7,762	6,666
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	—	240
現金及び現金同等物の期末残高	6,666	19,031

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科目	第64期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	第65期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	10,637	10,638
資本剰余金増加高	1	25
新株引受権の権利行使による増加高	1	25
資本剰余金期末残高	10,638	10,664
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	28,794	28,529
利益剰余金増加高	381	3,252
当期純利益	381	3,094
新規連結に伴う増加高	—	157
その他の増加高	—	0
利益剰余金減少高	646	811
配当金	642	803
役員賞与	4	3
その他の減少高	—	5
利益剰余金期末残高	28,529	30,970

財務諸表(単独)

貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第64期	第65期
	(平成15年3月31日現在)	(平成16年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	3,413	16,406
受取手形	651	572
売掛金	8,153	13,086
棚卸資産	12,745	11,607
その他	4,345	3,492
流動資産合計	29,309	45,165
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,679	7,031
機械及び装置	2,590	3,308
土地	4,983	4,983
その他	2,684	3,936
有形固定資産合計	16,938	19,259
無形固定資産		
投資その他の資産	540	521
投資有価証券	785	1,164
関係会社株式	4,296	4,443
その他	3,832	3,806
投資その他の資産合計	8,914	9,414
固定資産合計	26,392	29,195
資産合計	55,702	74,361
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	1,295	2,205
買掛金	1,378	2,714
短期借入金	400	840
未払金	1,499	2,689
未払法人税等	18	1,717
その他	1,247	2,178
流動負債合計	5,839	12,345
固定負債		
新株引受権付社債	312	—
新株予約権付社債	—	9,000
長期借入金	—	1,720
退職給付引当金	1,399	1,493
役員退職慰労引当金	812	851
固定負債合計	2,523	13,064
負債合計	8,363	25,410
(資本の部)		
資本金		
資本金	9,772	9,795
資本剰余金	10,638	10,664
資本準備金	10,638	10,664
利益剰余金	26,917	28,371
利益準備金	594	594
任意積立金	17,031	17,028
当期末処分利益	9,292	10,748
その他有価証券評価差額金	18	138
自己株式	9	18
資本合計	47,339	48,950
負債及び資本合計	55,702	74,361

損益計算書

(単位：百万円)

科目	第64期	第65期
	(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
売上高	25,614	36,439
売上原価	13,990	19,153
販売費及び一般管理費	11,154	14,056
営業利益	469	3,230
営業外収益	891	1,255
営業外費用	244	461
経常利益	1,116	4,023
特別利益	89	0
特別損失	136	172
税引前当期純利益	1,070	3,852
法人税、住民税及び事業税	62	1,754
法人税等調整額	395	159
当期純利益	612	2,256
前期繰越利益	9,000	8,974
中間配当額	321	481
当期末処分利益	9,292	10,748

利益処分

(単位：百万円)

科目	第64期	第65期
	(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
当期末処分利益	9,292	10,748
任意積立金取崩高	4	3
買換資産圧縮積立金取崩高	4	3
国庫補助金等圧縮積立金取崩高	0	0
合計	9,296	10,752
利益処分類	322	526
配当金	321	481
役員賞与金	—	45
買換資産圧縮積立金	1	—
国庫補助金等圧縮積立金	0	—
次期繰越利益	8,974	10,225

(注)買換資産圧縮積立金および国庫補助金等圧縮積立金は、租税特別法および法人税措置法の規定に基づくものであります。

会社概要

社名	株式会社ディスコ DISCO CORPORATION
本店所在地	東京都大田区東糶谷二丁目14番3号
創業年月日	1937年5月5日
設立年月日	1940年3月2日
資本金 (2004年3月31日現在)	9,795百万円
従業員 (2004年3月31日現在)	1,171名
主な事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 精密研削切断装置の製造および販売 精密研削切断装置のメンテナンスサービス 精密研削切断装置の保守部品の販売 精密研削切断装置のオペレーションやメンテナンスの研修サービス 精密研削切断装置の解体リサイクル事業 精密ダイヤモンド砥石の製造および販売 精密部品の有償加工サービス
事業所	本社 広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)
国内拠点	大阪支店、九州支店、仙台営業所、名古屋営業所、諏訪営業所

	ディスコグループ関連会社
国内法人	株式会社ディスコ エンジニアリング サービス 株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプライシブ システムズ 株式会社ディーエスディー 株式会社ダステック
海外法人	DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC EUROPE, GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U.K. LTD. DISCO HI-TEC MOROCCO SARL DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. DD Diamond Corporation S.E.A. Utensili Diamantati S.p.A. DISCO-SEA AMERICA, INC.

役員 (平成16年6月24日現在)

代表取締役 会長兼 CEO	関家 憲一
代表取締役 社長兼 COO	溝呂木 斉
常務取締役	関家 圭三
常務取締役	関家 一馬

取締役	中山 勉
取締役	関家 英之
取締役	梶山 啓一
取締役	溝呂木 隆夫
取締役	田村 隆夫

常勤監査役	玉利 晋
常勤監査役	古川 深志
監査役	浅海 芳久
監査役	木谷 孟

株式概要 (平成16年3月31日現在)

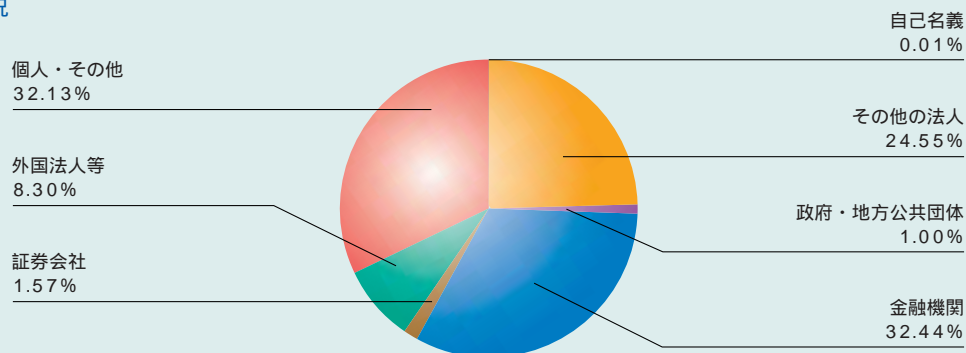
上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部(証券コード6146)

発行済株式総数 32,130,711株

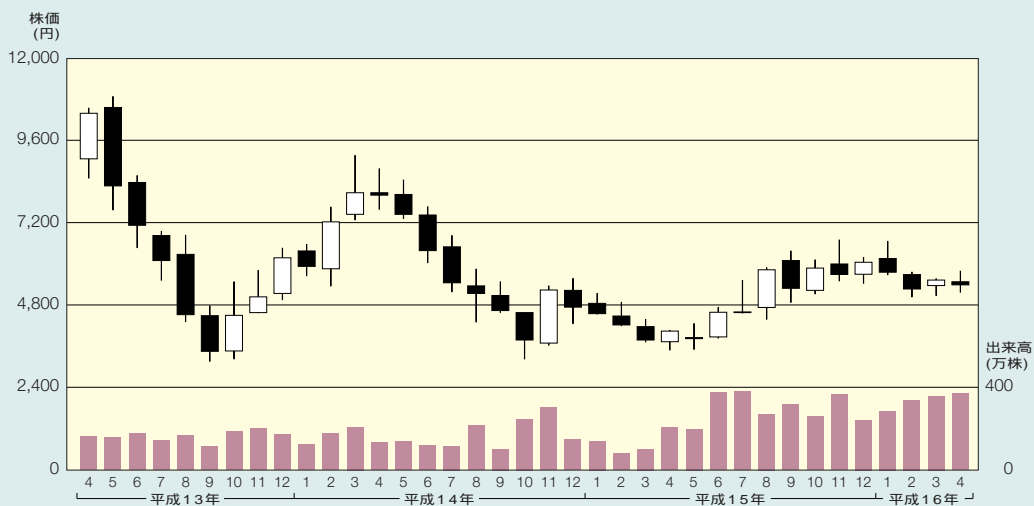
株主数 16,841名

大株主	株主名	株数	割合	大株主	株数	割合
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,626千株	8.17%	1	関家 臣二	1,433千株 4.46%
2	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	2,357千株	7.34%	2	日本生命保険相互会社	1,046千株 3.26%
3	株式会社ダイイチ企業	1,998千株	6.22%	3	関家 憲一	1,045千株 3.25%
4	株式会社ダイイチホールディングス	1,998千株	6.22%	4	野村信託銀行株式会社	878千株 2.73%
5	株式会社第一総業	1,709千株	5.32%	5	株式会社オレンジコーラル	846千株 2.63%

所有者別株式数分布状況



株価チャート



株 主 メ モ

決 算 期	毎年3月31日
定 時 株 主 総 会	毎年6月
利益配当金受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金受領株主確定日	毎年9月30日
基 準 日	定時株主総会については、毎年3月31日といたします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
名 義 書 換 代 理 人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 UFJ信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 所	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL (03) 5683-5111(代表)
同 取 次 所	UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
公 告 掲 載 新 聞	日本経済新聞

本報告書に関するお問い合わせ
株式会社ディスコ IR・渉外室 TEL (03) 3743-5013 / FAX (03) 3743-5210

ホームページアドレス

<http://www.disco.co.jp/>

